

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2025-008

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称/人员姓名	西部证券
时间	2025 年 10 月 31 日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事：宋嘉斌 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍公司基本情况和发展历程。 二、与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： Q1、公司在智能卡业务方面行业地位，主要客户及收入占比？ 答：公司是国内较早进入智能卡行业的企业之一，率先构建了涵盖芯片应用研发、模块封测、智能卡研发、生产、销售及终端应用开发的端到端全流程体系，实现了行业内智能卡一站式交付能力的率先突破，提升了产品一致性和交付效率，增强了技术门槛与客户粘性，在智能卡领域形成了差异化竞争优势与更高的附加值空间。公司与 THALES、IDEMIA 等国际领先的智能卡系统厂商建立了长期稳定的合作关系，产品外销占比超过 60%，是国内较早实现全球化布局的智能卡企业之一。公司通信智能卡产品在全球市场已形成一定的销售规模。 当前智能卡业务占公司总营收比重约 60%-70%，预计该业务收入规模将维持相对稳定，随着公司新拓展的半导体及热管理业务的增长，智

	能卡业务在公司总营收中的占比将逐步下调。 Q2、公司半导体业务主要产品 答：公司半导体业务主要产品包括载带、引线框架、铜针散热底板等半导体封装材料，以及模块封装、专用芯片产品等；相关产品主要满足MOSFET、SiC、IGBT功率模块等封装应用需求。 Q3、公司半导体封装材料业务增长主要原因及核心竞争力？ 答：近年来，半导体封装材料行业保持稳健增长，主要得益于下游功率电子应用的快速扩张。当前增长主要来自光伏逆变器、储能系统及新能源汽车三电系统等领域，这些应用场景对功率器件的高频、高压、高温运行性能提出了更严苛要求，从而推动了对高导热、低热阻、高可靠性封装材料的持续需求。随着AIDC（人工智能数据中心）基础建设加速，在电源与储能环节对高效率功率转换器件的需求显著增长，将成为半导体封装材料行业的新一轮增长驱动力。 公司在半导体封装材料领域构建了多维竞争优势：拥有从材料到结构件的垂直整合制造能力，掌握高精度化学蚀刻、电镀、钎焊与表面处理等核心工艺。公司长期专注高导热、高可靠性封装材料体系的开发，由单一封装材料供应商逐步发展为提供“封装材料+热管理结构件+液冷模块系统解决方案”的综合服务商，可为客户提供从材料选型、热仿真设计、工艺验证到系统装配的全流程支持。 Q4、公司液冷散热业务发展机缘？具体包括哪些产品？主要客户方向及进度？ 答：（1）公司液冷业务的发展契机主要源自AIDC基础设施投资建设的加速推进。随着AIDC的持续扩建，传统风冷技术已难以满足高性能计算和高功率模块运行时的散热需求。液冷技术以其高导热、高换热效率及低能耗的优势，正逐步成为主流散热路径。公司基于在功率半导体领域积累的高导热金属材料、蚀刻、电镀与钎焊等核心工艺能力，顺势切入液冷热管理赛道，实现了从封装材料到散热结构件，再到系统级液冷解决方案的自然延伸。 （2）公司已实现液冷产品线的全栈布局，从液冷板等核心组件逐步
--	---

扩展至二次侧系统级液冷方案，目前产品覆盖冷板、波纹管、分水器等核心组件，并可根据客户需求，提供定制化的整柜液冷一体化解决方案。

（3）当前公司液冷散热业务正处于积极市场开拓阶段，正加快推动核心客户的量产导入进程。目标客户群体主要包括国内头部服务器厂商、AI算力平台建设单位以及部分外资品牌在华的ODM/整机集成商。在客户推进方面，公司给国内厂商提供的液冷板产品因采用新技术工艺，目前处于样品测试阶段，验证周期相对较长。其中公司提供某台资企业的样品验证有望率先取得突破。此外，公司已与superX达成战略合作，共同拓展海外液冷市场。

Q5、公司和superX共同投资设立合资公司的合作商业模式？

答：公司本次和superX共同投资设立合资公司，核心战略在于整合各方优势，共同开拓全球AIDC机柜液冷产品市场，并以此拓展公司的海外销售渠道。

合资公司将专注于定制化的机柜级液冷解决方案的设计，会有利润留存，其中液冷散热部件订单将通过ODM模式由公司控股子公司承接形成良好的内部业务协同。本公司通过全资子公司香港澄天以自有资金出资，持股 25%。此举有望加速公司液冷产品在海外市场的规模化落地。

Q6、介绍一下公司微通道水冷板（MLCP）技术情况

答：MLCP 是一种将传统封装散热结构与液冷通道深度整合的冷板技术，其通过在封装材料内开设微米级通道，使冷却液更靠近芯片热源，从而显著降低热阻并提升换热效率。其集成化设计摒弃了传统外附冷板模式，可直接与高功率及多芯片模块进行结构耦合。

公司在高导热金属封装材料、精密蚀刻及电镀复合等工艺方面拥有深厚积累，与MLCP技术路线的协同性高。目前，公司正积极推进MLCP的样品送测与产线准备工作，重点客户样品已交付，后续产能规划将严格依据市场反馈及客户订单情况推进，力争把握未来在AI服务器、功率模块等高热流密度领域的发展机遇。

风险提示	公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2025-10-31